# LAGENAUFBAU HDI (Standard)

HDI08_3+2(4b)+3_1,50

**8 - Lagen**

Kern: 0,93 mm Cu 35/35 µm

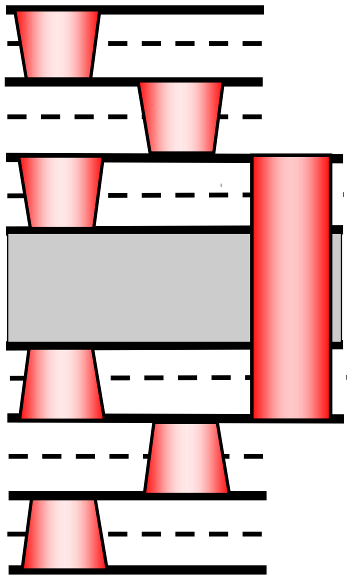
**WE-Artikel Nr.:**

**3 + 2 (4B) + 3**

**KUNDE:**

**nur CBT Schopfheim**

WÜRTH ELEKTRONIK



| LAGENBEZEICHNUNG KUNDE | WE | BASIS-Material | CU | PREPREG ANZAHL/TYP | ENDDICKE [µm] | KUNDEN-FORDERUNG [µm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP/VS | Folie | 12 µm | 1) | 12 | |
| | | | | 1 x 1080 | 60 | |
| 2 | VSK2 | Folie | 12 µm | | 30 | |
| | | | | 1 x 1080 | 60 | |
| 3 | VSK1 | Folie | 9 µm | | 30 | |
| | | | | 1 x 1080 | 60 | |
| 4 | 2 | | 35 µm | | 33 | |
| | | 0,930 mm | | | 930 | |
| 5 | 3 | | 35 µm | | 33 | |
| | | | | 1 x 1080 | 60 | |
| 6 | RSK1 | | 9 µm | | 30 | |
| | | | | 1 x 1080 | 60 | |
| 7 | RSK2 | Folie | 12 µm | | 30 | |
| | | | | 1 x 1080 | 60 | |
| 8 | BOT/RS | Folie | 12 µm | 1) | 12 | |

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material: 1500

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MATERIALDICKE:** | **1,50** | +/- | 0,12 | mm | Datum: | Bearbeiter: |
| DICKE über galv. Endoberfläche | 1,59 | +/- | 0,15 | mm | | |
| DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer | 1,65 | +/- | 0,17 | mm | | |
| Kundenforderung: | | +/- | | mm | Messstelle: | |

| Erstellt am | von | Geprüft am | von | Freigegeben am | von | Revision | Seite: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2006 | **S. Keller** | 04.05.2006 | M.Kress | 25.04.2006 | R. Schönholz | 00 | 24- |